

# 第4回 JEITA プリンテッドエレクトロニクス セミナー ～ IoT社会を実現する基盤技術と標準化戦略 ～

プリンテッドエレクトロニクスは、導電性／半導体／絶縁インクなど各種印刷技術駆使して電子デバイスを製造する技術で、Society 5.0 (超スマート社会) を実現する基盤技術となることが期待されています。特に近年は、急速に発展するIoT技術のキーテクノロジーとして、技術開発、ビジネス展開及び関連する国際標準化の動きが活発になっており、産業動向は目が離せない状況となっております。そこでこの機会に、IEC/TC119 (プリンテッドエレクトロニクス) 及びIEC/TC124 (ウェアラブルエレクトロニクス) の国際標準の開発動向をはじめ、プリンテッドエレクトロニクス分野の最新製品開発動向や解析技術の事例を紹介するとともに、新しい技術でビジネスに取り組むベンチャー動向等、普及に向けた取り組みや今後の標準化の戦略等についてのセミナーを開催致します。

日 時 : 2019年1月31日 (木) 13:30～17:00 (受付開始 13:00)

場 所 : 東京ビッグサイト 会議棟 6階 610会議室  
東京都江東区有明3-11-1 Tel 03-5530-1111 (代表)  
<http://www.bigsight.jp/access/>

主 催 : 一般社団法人電子情報技術産業協会 プリンテッドエレクトロニクス標準化専門委員会

定 員 : 60名 (定員になり次第、締め切らせていただきます)

参加費 : JEITA会員 : 1,080円、一般 (JEITA非会員) : 3,240円 (消費税を含みます。別途、請求書をお送りします。)  
※会員・一般 (非会員) については、JEITAホームページでご確認ください。

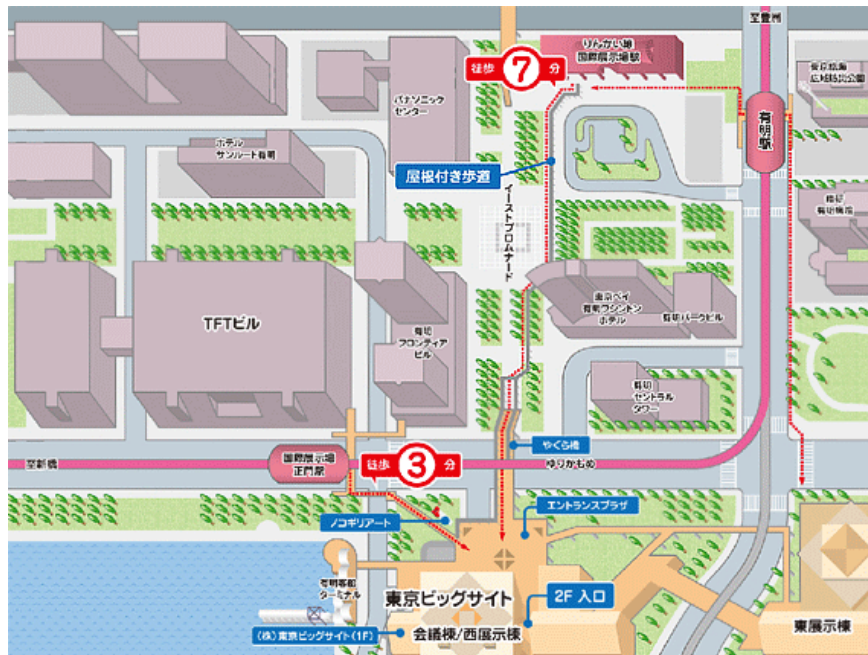
<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>

申込方法 : 以下のURLから参加登録をお願いします。

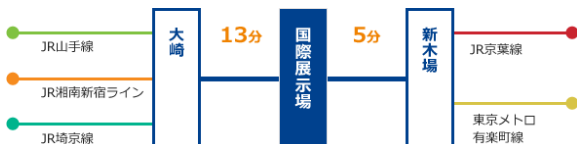
【参加登録フォーム】 [https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form\\_tss/form.cgi](https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form_tss/form.cgi)

※プログラムは裏面をご参照ください。都合により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

## 会場へのアクセス



りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分



ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分



**Program**

【司会】 前田 修一 プリンテッドエレクトロニクス標準化専門委員会 委員長 (三菱ケミカル株式会社/CEREB A)

13:30	<p>開会挨拶</p> <p>前田 修一 プリンテッドエレクトロニクス標準化専門委員会 委員長 (三菱ケミカル株式会社/CEREB A)</p>
13:35 - 13:45	<p>来賓挨拶</p> <p>「国の標準化政策について」(予定)</p> <p>山本 克己 氏 (経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課長補佐)</p>
セッション I	
13:45 - 14:15	<p>講演①</p> <p>「IOT時代におけるRFIDの活用と今後の展開」</p> <p>平林 勇人 氏 (トッパン・フォームズ株式会社 中央研究所 所長)</p> <p>&lt;概要&gt;トッパンフォームズは、これまでお客様の業務特性に合わせたRFIDタグ・ラベルなどの媒体から運用するシステムやアプリケーションまでを開発・提供することでさまざまな「モノ」の情報収集・活用をサポートしてまいりました。本講演では、これまで開発を進めてきたRFID関連製品・導入事例とプリンテッドエレクトロニクス等を活用したIOT時代における次世代RFIDの取組について紹介します。</p>
14:15 - 14:45	<p>講演②</p> <p>「フレキシブルデバイス開発に資する機能性フィルムの解析と創出」</p> <p>宍戸 厚 氏 (東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 教授)</p> <p>&lt;概要&gt;近年、高分子フィルムを利用したフレキシブルデバイスやソフトロボティクス材料の開発が進んでいます。新たな光力学機能を有する高分子フィルム開発への期待が大きくなっています。一方、湾曲に伴うデバイスの破壊や劣化の課題も浮き彫りになってきました。本講演では、高分子フィルムの光力学機能創出と解析のアプローチとして、フィルム湾曲に伴う表面ひずみに定量解析法と光重合による新たな分子配向法を紹介します。</p>
14:45 - 15:15	<p>講演③</p> <p>「プリンテッドエレクトロニクス国際標準化からみたビジネス動向の兆し」</p> <p>関根 千津 氏 (住友化学株式会社 理事 技術・研究企画部 主幹)</p> <p>&lt;概要&gt;プリンテッドエレクトロニクス(PE)は、今後急速に普及が期待されるIoT社会の実現に欠かせないキーテクノロジーの1つであり、市場の立ち上がりに先立つ形で、国際標準化の動きが活発に動き出しました。最近はその動きに変化がみられ、IEC/TC119国際標準に関わるプレイヤーや提案される規格の中身もシフトしつつあります。本講演では、こういった変化を含めた様々な切り口から、PE国際標準化の現状と変化の兆しを紹介します。</p>
セッション II	
15:30 - 16:00	<p>講演④</p> <p>「インクジェットによるフレキシブル配線の量産最前線、これまでとの違い」</p> <p>清水 信哉 氏 (エレファンテック株式会社 代表取締役社長)</p> <p>&lt;概要&gt;エレファンテックは、インクジェット印刷によるフレキシブル配線のパイオニアであり、既存エッチング品レベルの性能を実現したFPC量産を行なっています。本講演では、それを可能にしたこれまでとの技術的な違い、狙っているマーケット、それに対するアプローチ、今後の展開をご紹介します。</p>
16:00 - 16:30	<p>講演⑤</p> <p>「金属ナノ粒子を基盤とするインクジェットおよびスクリーン印刷用導電材料」</p> <p>金原 正幸 氏 (株式会社C-INK 代表取締役社長)</p> <p>&lt;概要&gt;プリンテッドエレクトロニクスにおいて印刷用材料に求められる特性は、下記の項目が重要です。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)安定な生産プロセスを実現するために必須の材料の使いやすさ</li> <li>2)望みの特性を常に再現するばらつきが無さ</li> <li>3)基板耐熱温度に適應する後処理工程の容易さ</li> </ol> <p>上記特性を引き出すC-INK導電材料の取組みについて紹介します。</p>
16:30 - 17:00	<p>講演⑥</p> <p>「ウェアラブルエレクトロニクスの国際標準化」</p> <p>前田 郷司 氏 (東洋紡株式会社 総合研究所 主幹)</p> <p>&lt;概要&gt;本講演では、衣服型ウェアラブルデバイスの開発事例および応用事例に基づき、ウェアラブル製品についての標準化の必要性、課題、さらにIEC/TC124を中心に現在進行中の国際標準化動向について解説します。</p>
17:00	<p>総括・閉会挨拶</p> <p>鎌田 俊英 氏 (産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター センター長)</p>